

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2025年3月21日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议<br><input type="checkbox"/> 其他（）   |
| 参与单位名称        | 民生证券、西部利得基金、富国基金、融通基金、海富通基金、兴业基金   |
| 活动时间          | 2025年3月18日、3月19日   |
| 活动地点          | 电话会议、反路演   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟<br>证券事务代表：黄沈曩<br>投资者关系：王佳颖   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司的MCP产品主要针对哪些下游终端？</p> <p>答：公司MCP系列产品具有NAND Flash和DDR多种容量组合，Flash和DDR均为低电压的设计，核心电压1.8V可满足目前移动互联网和物联网对低功耗的需求。其中，DDR包含LPDDR1、LPDDR2和LPDDR4x等不同规格，为用户提供更加灵活和丰富的选择。MCP通过将低功耗DRAM和NAND Flash进行合封，简化走线设计，节省组装空间，降低整体系统成本，提高整体集成度和可靠性，适用于PCB布板空间狭小的应用。公司MCP产品凭借设计优势已在多个知名主控平台通过认证，被广泛应用于功能手机、MIFI、通讯模块等产品。</p> <p>2、公司对于AI相关终端有哪些规划？</p> <p>答：我们高度关注AI端侧应用发展趋势，并与上下游合作伙伴积极探索相关终端产品与公司产品协同配合的机会。</p> |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>3、SLC NAND 替代 NOR 的趋势主要在哪些方面？</p> <p>答：我们目前主要看到在消费电子终端，随着客户对存储容量的需求逐步升级，会有使用 SLC NAND Flash 产品替代 NOR Flash 的趋势。</p> <p>4、公司的 DDR3L 产品主要针对哪些终端？</p> <p>答：公司研发的 DDR3(L)系列是可以传输双倍数据流的 DRAM 产品，具有高带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领域应用广泛。</p> <p>5、公司的直销和经销比例如何？</p> <p>答：公司目前直销占比相对较高，产品销售采用“经销、直销相结合”的销售模式。经销模式下，公司与经销商之间采用买断式销售；直销模式下，终端客户直接向公司下订单。</p> |
| 日期 | 2025 年 3 月 21 日  |